

リグニンを用いたエポキシ系熱硬化性樹脂の開発

小宮 玄*, 八甫谷 明彦*, 寒河江 浩久**, 高橋 昭雄***

Application of Lignin for Epoxy-Based Thermoset Resin

Gen KOMIYA*, Akihiko HAPPOYA*, Hirohisa SAGAE**, and Akio TAKAHASHI***

* 株式会社東芝 (〒183-8511 東京都府中市東芝町1)

** 株式会社メイコー (〒243-0414 神奈川県海老名市杉久保南3-35-6)

*** 横浜国立大学 (〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5)

* Toshiba Corporation (1, Toshiba-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8511)

** MEIKO ELECTRONICS CO., LTD (3-35-6, Sugikubo-minami, Ebina-shi, Kanagawa 243-0427)

*** Yokohama National University (79-5, Tokiwadai, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-8501)